

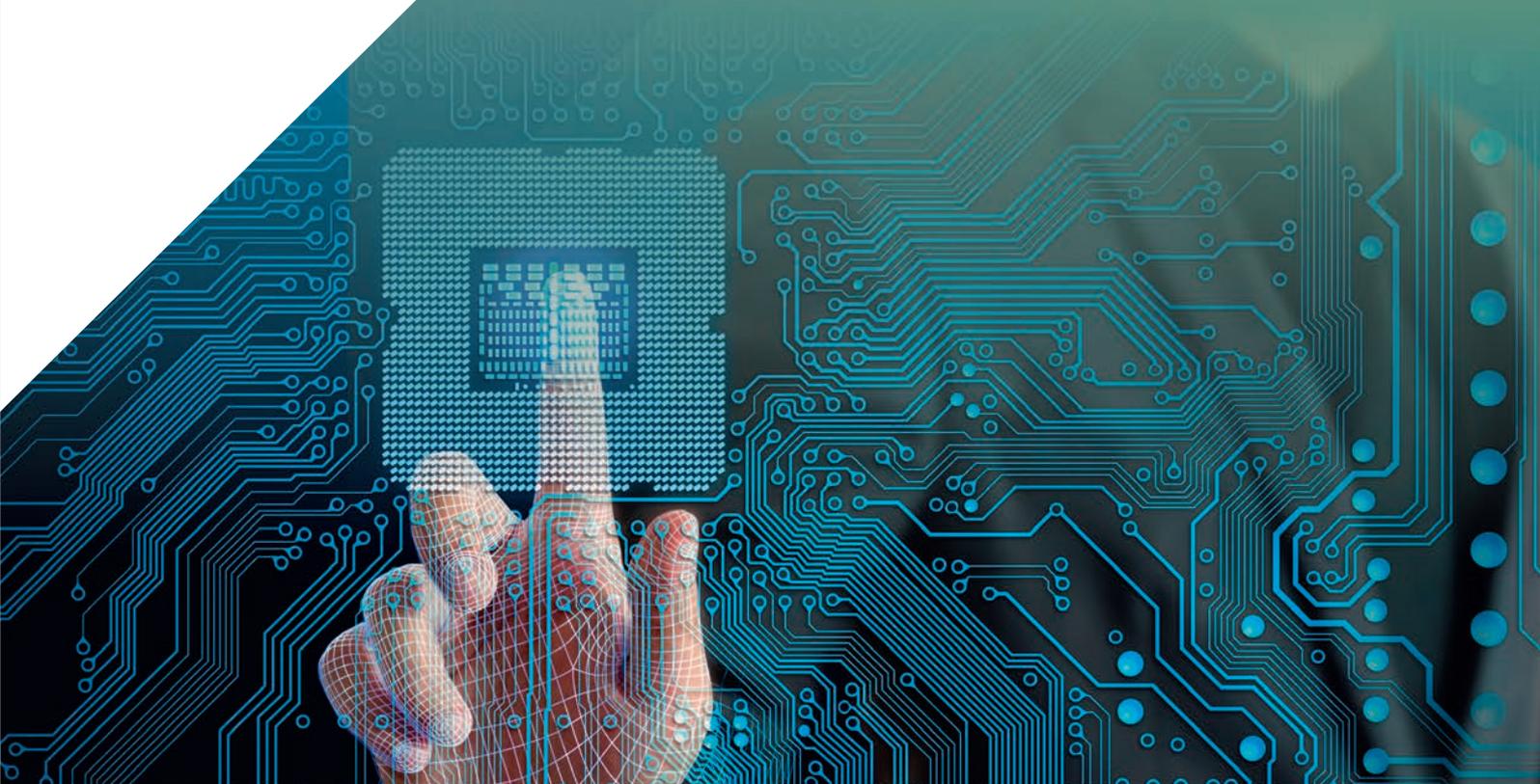
FED

Fachverband für Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

26. FED-Konferenz

27./28. September 2018
Bamberg

Design- und Fertigungsprozesse für smarte Elektronik



Mit freundlicher Unterstützung von:



Raum für Weiterbildung und Vernetzung

Komplex, sparsam, nachhaltig, vernetzt, intelligent – smarte Elektronik hat viele Eigenschaften. Die Leistungen an der Grenze des technisch Machbaren unter Zeit- und Kostendruck zu entwickeln und zu fertigen, fordert uns jeden Tag aufs Neue.

Diese Entwicklung, oder bildhaft gesprochen, den Wind, können wir nicht ändern. Aber wir können die Segel richtig setzen. Sie dabei zu unterstützen, ist unsere Mission.

Die FED-Konferenz bietet den Raum. An zwei Tagen haben Sie die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren, Wissen und Erfahrungen auszutauschen, wertvolle Kontakte auch über Branchengrenzen hinweg zu knüpfen.

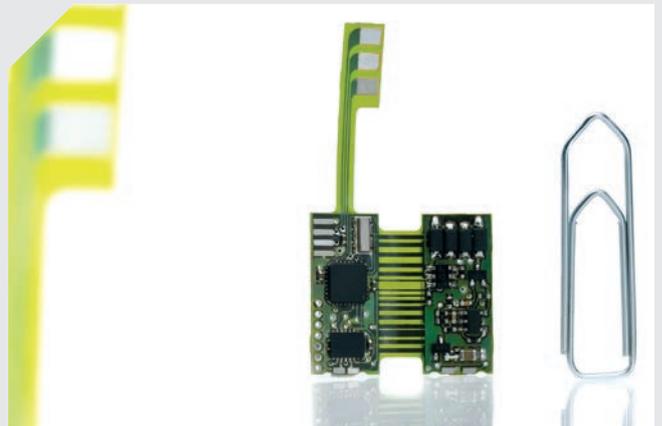
In verschiedenen Blöcken bieten wir Fachvorträge und Diskussionsrunden für Leiterplattendesigner und Experten in der Fertigung. Speziell an Entscheider richten sich Impulsvorträge von Managementprofis, IT-Experten und Juristen.

Ein Block bearbeitet das riesige Gebiet der dreidimensionalen Aufbau- und Verbindungstechnik und multifunktionalen Leiterplatten aus der Sicht der Anwender. Sehens- und hörensenswert sind unsere Keynotes: Am ersten Konferenztag nordet uns Spitzenforscher Professor Wolfgang Ertel auf Robotik und künstliche Intelligenz ein. Am zweiten Tag gehen wir bei Pilot und Managementcoach Peter Brandl an Bord.

Unser Rahmenprogramm startet mit einer Stadtführung durch Bamberg, dessen Altstadt gerade das 25-jährige Jubiläum Unesco Welterbe feiert. Danach können Sie auf dem Festabend Energie tanken, netzwerken und die Verleihung des PCB Design Awards an die besten Leiterplattendesigner miterleben.

Wir bieten den Raum. Nehmen Sie sich die Zeit!

Ihr
Prof. Dr. Rainer Thüringer
Vorsitzender des FED-Vorstandes



Multifunktional und dreidimensional

Um multifunktionale Leiterplatten und dreidimensionale Aufbau- und Verbindungstechnik dreht sich (fast) alles auf der 26. FED-Konferenz. Erst diese Konstruktionen machen smarte und leichte Elektronik möglich. Sie vergrößern die Packungsdichte, reduzieren das Gewicht, erhöhen die Zuverlässigkeit und bieten neue gestalterische Freiheiten.

Multiboard, Embedding, Flex- und Starrflex-Leiterplatte oder MID unterscheiden sich im Konzept, in ihren technischen Eigenschaften und in ihren konstruktiven Vorteilen und Grenzen. Mit dem Wissen um Aufbau, Eigenschaften und Möglichkeiten können Entwickler die funktional, fertigungstechnisch und kostenseitig beste Lösung für ihr Projekt auswählen.

Hilfe bietet auch der FED-Arbeitskreis 3D-Elektronik (AK 3D). Der Arbeitskreis sammelt, analysiert und gliedert die Vielfalt der Technologievarianten systematisch und praxisnah. Zur Fachkreisarbeit gehören CAD-Systeme und Datenformate. Denn bei allen Möglichkeiten der 3D-Elektronik stellt sich eine zentrale Frage: Wie unterstützen unsere EDA-Werkzeuge diese Funktionen? Die vom AK 3D moderierte Diskussionsrunde gibt Antwort.

Wie bei allen Schaltungsträgern gilt erst recht für 3D-Elektronik: Die Gesamtsystemkosten lassen sich nur dann niedrig halten, wenn die konstruktiven Möglichkeiten und Eigenschaften optimal genutzt werden. Das funktioniert nur, wenn Entwicklung und Fertigung früh und eng zusammenarbeiten. Beispiele zeigen die Vorträge und Exponate.

Einen Blick in das weite Feld der gedruckten organischen Elektronik gibt otego. Das Startup bedruckt Folien im Rolle-zu-Rollen-Verfahren und faltet sie zu einem zentimetergroßen Würfel. Anwendungsgebiet der thermoelektrischen Generatoren ist der riesige Markt des Energy Harvesting.

Was beim 3D-Druck von Elektronik schon heute möglich ist, zeigt das Fraunhofer IZM. Außerdem schauen wir in die Zukunft auf eine Leiterplattenfertigung 2030. Zuvor starten wir in der Nanowelt von NanoWired. Das KlettWelding-Verfahren ermöglicht das Fügen und Kontaktieren von Halbleitern durch Zusammenpressen bei Raumtemperatur.

Donnerstag, 27. September 2018

ab 07:30

Anmeldung und Besuch der Ausstellung

08:30

Eröffnung der Konferenz und Begrüßung im Hegel-Saal
Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED

08:40

Keynote: Künstliche Intelligenz, lernfähige Roboter und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt
Prof. Dr. Wolfgang Ertel, Beauftragter für Nachhaltige Entwicklung - Hochschule Ravensburg-Weingarten

09:45

PAUSE FÜR GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

MANAGEMENT

Konferenzraum 8 –
„Jacopo Tintoretto“

ENTWICKLUNG & DESIGN

Konferenzraum 9 –
„Ferdinand Tietz“

FERTIGUNG & TEST

Konferenzraum 3 –
„Veit Stoß“

MULTIFUNKTIONALE LEITERPLATTEN

Konferenzraum 2 –
„Tilman Riemenschneider“

10:30

Unternehmenserfolg durch zeitgemäßen B2B-Vertrieb: Vertriebsexzellenz für den Mittelstand

Holger Steitz
Sale Direct GmbH

HDI kostengünstig einsetzen: Wie das Design die Kosten beeinflusst und Kostentreiber eliminiert werden

Harald Antonitsch
AT&S

RFID im PCB: Smarte Leiterplatten mit eingebetteter RFID steuern die Elektronikfertigung 4.0 – Praxisbericht

Alexander Schmoldt
Murata

Klett-Welding: elektrisches Kontaktieren von Bauteilen bei Raumtemperatur über Nanodrähte

Olav Birlem
NanoWired

11:15

Social Media Marketing im B2B: nachhaltige Leadgenerierung und Recruiting

Sanjay Sauldie
Digital Business Consultant

Leiterplattendokumentation vom Material bis zum Nutzen – was der Leiterplattendesigner liefern muss

Martin Sachs
db electronic

Traceability in der Kleinserienfertigung: Chancen permanenter Datenerhebung und -analyse

Andreas Kraus
Kraus Hardware

Massenfertigung von energieautarken thermoelektrischen Generatoren für das Energy Harvesting

Matthias Hecht
otego

12:00

MITTAGSPAUSE (im Restaurant Regnitz und in der Gaststätte Plückers) – GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

13:15

Führen ohne Vorgesetztenfunktion in Teams und Projekten

Torsten Großmeier und
Theo Veltkamp, COMENO
company consulting GmbH

Modulares Multiboard Design am Beispiel Elektromobilität mit hohen Spannungen und maximaler Stromtragfähigkeit

Herbert Ritthaler, Zuken

Die Chancen der Digitalisierung für zukunftssichere Baugruppenfertigung nutzen

Jürgen Friedrich
KurtzErsa

Dreidimensionale Aufbau- und Verbindungstechnik auf Keramikbasis

Dr.-Ing.Uwe Partsch
Fraunhofer-Institut für
Keramische Technologien
und Systeme IKTS

14:00

Werkzeuge zur gezielten Entlastung vom Alltagsdruck in Beruf und Privatleben

Dr. Wolfgang Dietrich
SABINE DIETRICH & Co.

Verständliche Design Rule Checks für DFM, DFA, DFT, SI und PI

Dirk Müller
FlowCAD

Warum Fertigungs-ausrüster heute mit ihren Kunden Workflows Lösungen für die smarte Fabrik entwickeln

Oliver Kraus, ASM

Vom Design zur geprüften 3D-Baugruppe: NPI/Industrialisierung von 3D-Elektronik

Michael Matthes
Wittenstein

14:45

PAUSE FÜR ERFRISCHUNGEN, GESPRÄCHE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

15:30

Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung im BGB erhöht Haftungsrisiko in der Lieferkette

Dr. Kai-Oliver Giesa
Rechtsanwalt

Hardware und Firmware agil entwickeln: Agile Hardware – aber wie? Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis

Mario Blunk
Blunk electronic
und

Dr. Tobias Kästner
Method Park Engineering

Solder Limits: Updating UL Recognized PCBs for the Age of Surface Mount

Emma Hudson
UL

Multiboard, Embedded, Flex-/Starrflex, MID ... Wie ist die EDA-Welt für das Design von 3D-Technologien gerüstet?

– moderierte Diskussion
Anbieter von EDA-Tools zeigen in Kurzpräsentationen ihre 3D-Features. Im Anschluss können alle Teilnehmer ihre Fragen in einer moderierten Diskussion an die EDA-Experten richten.

16:15

Datenschutzrisiken für Unternehmen mit Inkrafttreten der DSGVO

Ralf Wickert
Rechtsanwalt

Die neue UL: Konsequenzen für Leiterplattenhersteller und Baugruppenfertiger – moderierte Diskussion

Diskussionsleiter:
Jürgen Deutschmann, AT&S

17:00

17:30

Geführte Tour durch die Bamberger Altstadt – Motto: Faszination Weltkulturerbe

19:30

Empfang und Einlass zur Abendveranstaltung

20:00

Abendveranstaltung im Hegel-Saal mit der Verleihung des PCB Design Awards

Freitag, 28. September 2018

ab 08:00

Anmeldung und Besuch der Ausstellung

08:30

Eröffnung des zweiten Konferenztages im Hegel-Saal
Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED

08:40

Hurricane Management – Schubhebel für die Unternehmenskultur im 21. Jahrhundert
Peter Brandl, Berufspilot, Fluglehrer, Managementberater

09:45

PAUSE FÜR GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

MANAGEMENT

Konferenzraum 8 –
„Jacopo Tintoretto“

ENTWICKLUNG & DESIGN

Konferenzraum 9 –
„Ferdinand Tietz“

FERTIGUNG & TEST

Konferenzraum 3 –
„Veit Stoß“

MULTIFUNKTIONALE LEITERPLATTEN

Konferenzraum 2 –
„Tilman Riemenschneider“

10:30

Die Chancen von Digitalisierung und Standardisierung für deutsche Fertiger von Musterbaugruppen

Jan Marloth, Becktronic und
Felix Plitzko, AISLER

Hardware für das Internet der Dinge (IoT) – Anforderungen an die Vernetzung von Geräten und Sensoren

Dirk Bause
SYS TEC electronic

Prozessanforderungen für die Verarbeitung von Bauteilen mit 250 µm Pitch

Rainer Taube
TAUBE ELECTRONIC

Embedding von HF-Komponenten für hochgenaue HF-Antennen

Thomas Gottwald
Schweizer Electronic

11:15

IT-Sicherheit für die digitale Industrie: ganzheitliche Ansätze für KMU

Thomas Dexheimer,
Fraunhofer-Institut für sichere
Informationstechnologie SIT

Entwicklung ganzheitlicher Systemlösungen und zukünftige Anforderungen an Industriedisplays und MMI

Patrick von Unold
Data Modul

IPC-A-600 / IPC-A-610 - Fehlerbilder aus der täglichen Praxis der Leiterplattenanalyse

Thomas Kuhn
HTV

SMD-Embedding für kleine und mittlere Stückzahlen am Beispiel eines 8-Kanal-Multiplexers

Johannes Blum
ILFA

12:00

MITTAGSPAUSE (im Restaurant Regnitz und in der Gaststätte Plückers) – GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

13:15

Die Chancen verzahnter IT-Systeme und Automatisierung der Lieferkette für Baugruppenkalkulation und Angebotserstellung, Bauteilebeschaffung und Stammdatenpflege sowie der Umgang mit Bauteilverfügbarkeit und Allokation

Statements und Diskussion:
Thomas Kaiser, CCS
Dirk Müller, FlowCAD
Helmut Krautwurm, Bay-Soft

Design for Reliability oder wie kann der Entwickler die Leiterplattenzuverlässigkeit beeinflussen

Helge Schimanski
Fraunhofer ISIT

Voids und Lunker und deren Einfluss auf die Lebensdauer RoHS-konformer Lötverbindungen

Lutz Bruderreck
TechnoLab

Die Zukunft der Leiterplatte: integrierte Funktionen, neue Materialien, Marktzyklen, disruptive Einflüsse

Marc Nikutowski
NCAB Group

14:00

Design for Inspectability: Empfehlungen für die 100%ige Inspizierbarkeit von Baugruppen

Michael Mügge
Viscom

Einflussfaktoren im SMD-Prozess und die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Voids und Lunkern

Dr.-Ing. Heinz Wohlraabe
TU Dresden

Dreidimensionale Elektronikmodule: ressourcenschonende Fertigung individualisierbarer Produkte

Ulf Oestermann
Fraunhofer IZM

14:45

PAUSE FÜR ERFRISCHUNGEN, GESPRÄCHE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

15:15

Wertstromorientiertes Prozessmanagement – best practice Lean Management in der Elektronikfertigung

Christoph Heuser und Rudolf Dörr, FEIG ELECTRONIC

Aktive Stücklisten und verknüpfte Dokumentation für Qualität, Genauigkeit und Umsetzbarkeit

Christian Keller
Altium

Neues Prüfverfahren vermeidet „Fake Tests“ und garantiert die Qualität von Testprogrammen

Hans Baka
Digitaltest

IML SmartWave Panels: dreidimensional geformte Kunststoffbauteile mit integrierter Elektronik

Christoph Ernst
Kunststoff Helmbrechts

16:00

Optimieren der Baugruppenentwicklung durch Verringerung des Time-to-Market

Jens Arnold
breflex electronic

Automatisierte Leiterplatten-Kriechstromanalyse in 2D und 3D

Christos Fontounasios
Mentor

Optimierte Handbestückung unter Einsatz einer Datenbrille – Praxisbericht zum BMBF-Projekt OptED

Jeannine Budelmann
Budelmann Elektronik

Neue Ansätze zur Herstellung mechatronischer Module

Prof. Dr. Herbert Reichel,
Hochschule Hof,
und Prof. Dr. Marcus
Reichenberger, TH Nürnberg

16:45

Verabschiedung der Konferenzteilnehmer in der Ausstellung und Ausblick auf 2019 in der Ausstellung
Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED

Keynotes

Künstliche Intelligenz, lernfähige Roboter und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt

Prof. Dr. Wolfgang Ertel

Serviceroboter, Smart Homes und Robotertaxis - alles Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) - werden unser Leben in wenigen Jahren stark verändern. Der Referent mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Künstlichen Intelligenz (KI) wird über maschinelles Lernen, automatische Diagnose in Technik und Medizin sowie über Serviceroboter für alte Menschen und Menschen mit Behinderung und über neueste Forschungen zur Kreativität in der KI berichten. Anhand spektakulärer Erfindungen wird er aufzeigen, dass das faszinierende Zeitalter der KI und der autonomen Systeme längst begonnen hat.

Lernfähige Roboterautos führen demnächst zu einer Revolution beim Personennahverkehr mit optimalem Komfort und gleichzeitig deutlich besserer Ökobilanz. Im nächsten Schritt werden Serviceroboter im Haushalt putzen, aufräumen und bügeln. Einerseits sind derartige Systeme ein Segen für die Menschheit. Aber es gibt zum Beispiel auch Killerroboter. Und viele Menschen haben Angst vor KI-Systemen, die unsere Arbeitsplätze und in ferner Zukunft vielleicht die ganze Menschheit vernichten. Der Referent diskutiert diese Fragen und Ängste und präsentiert Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft mit KI.

DO
27.09.2018
08:40 UHR



Schubhebel für die Unternehmenskultur im 21. Jahrhundert

Peter Brandl

Die Daten der Profiluftfahrt beeindrucken: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen und hochkomplexer Systeme ist das Flugzeug seit langem das sicherste Verkehrsmittel. Selten passieren in der Luftfahrt Fehler aufgrund mangelnder Technik. In über 80 Prozent liegt die Ursache beim Menschen. „Diese menschlichen Faktoren kann man eins zu eins auf das Geschäftsleben übertragen“, sagt Peter Brandl.

Der Berufspilot und Fluglehrer zieht erstaunliche Parallelen zwischen professioneller Luftfahrt und Unternehmensalltag. Locker und unterhaltsam projiziert der Kommunikationsprofi seine Erfahrungen aus der Fliegerei auf Führung und Kommunikation im Unternehmen. Mit Leidenschaft und mitreißender Rhetorik erklärt der mehrfache Autor und Redner, wie wir die Strategien der Profipiloten auf die Kommunikation in unseren Teams übertragen können.

Das Management der Zukunft baut auf Kommunikation. Was braucht unser Projekt, was brauchen unsere Mitarbeiter, um eine Erfolgsstory zu schreiben? Wie sollten wir im 21. Jahrhundert mit Fehlern umgehen? Boarding für den 60-Minuten-Flug mit Peter Brandl ist am zweiten Konferenztag.

FR
28.09.2018
08:40 UHR



Tagungsort und Abendveranstaltung

Das Welcome Kongress Hotel Bamberg liegt am Ufer der Regnitz in unmittelbarer Nähe zur Altstadt Bamberg. Diese wartet mit dem größten, unversehrt erhaltenen historischen Stadtkern in Deutschland auf. Seit 1993 ist Bamberg als Weltkulturerbe in der Liste der UNESCO eingetragen.

Nach dem ersten Kongresstag können Sie die Sehenswürdigkeiten Bambergs bei einer Stadtführung entdecken. Danach laden wir Sie ein zur Abendveranstaltung in den Hegel-Saal der benachbarten Konzert- und Kongresshalle. In festlicher Atmosphäre, bei gutem Essen und umrahmt von einem Unterhaltungsprogramm haben Sie Gelegenheit, abseits vom Tagesgeschäft Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Der Höhepunkt in diesem Jahr: Die Verleihung des PCB Design Awards 2018.

Welcome Kongresshotel Bamberg

Mußstraße 7
96047 Bamberg
Tel: +49 951 7000-0
info.bak@welcomehotels.com

Anreise und Übernachtung

Für Konferenzteilnehmer, die mit dem Auto anreisen, bietet das Hotel eine große Tiefgarage mit kostenpflichtigen Parkplätzen. Bitte nehmen Sie ihre Zimmerreservierung selbst vor. Die Kosten für die Übernachtung tragen die Konferenzteilnehmer. Für die Übernachtung in Bamberg haben wir eine Auswahl an Hotels auf der Internetseite der FED-Konferenz (www.fedkonferenz.de) zusammengestellt. Unter dem Stichwort FED sind Kontingente eingerichtet. Bitte reservieren Sie Ihre Zimmer so früh wie möglich. Die Kontingente verfallen ab Juli/August 2018. Weitere Übernachtungsmöglichkeiten und Veranstaltungsangebote in Bamberg finden Sie im Internet unter www.bamberg.info.

Kontakt

FED e. V.

Frankfurter Allee 73C
10247 Berlin
Tel. +49 30 340 60 30 50
Fax +49 30 340 60 30 61
www.fedkonferenz.de
konferenz@fed.de



PCB DESIGN AWARD

Siegerehrung beim Wettstreit der Leiterplattendesigner

Fachleute sind sich einig: „Die Intelligenz sitzt vor dem Bildschirm.“ Um diese Intelligenz – die Leistung des Leiterplattendesigners – geht es beim PCB Design Award. Darum steht bei diesem Wettbewerb nicht das Produkt im Mittelpunkt, für das eine Baugruppe entwickelt wurde. Entscheidend beim PCB Design Award sind die Aufgabe und Randbedingungen, die an den Designer gestellt wurden und wie er diese gelöst hat.

Aufgerufen waren alle Leiterplattendesigner in Deutschland, der Schweiz und Österreich, eine Arbeit aus ihrer Berufspraxis einzureichen. An dieser Arbeit sollten die PCB-Designer die an sie gestellte Aufgabe und Lösung beschreiben und mit Detailbildern und Fotos der Baugruppe veranschaulichen. Eine sechsköpfige Fachjury nahm die Bewertungen vor – nach technischem Anspruch, Fertigbarkeit und Dokumentation – unabhängig, streng vertraulich und anonym.

Seit 2012 verleiht der FED alle zwei Jahre den wertvollen Berufspreis, der als Ritterschlag in der Community gilt. Wer in diesem Jahr zu den besten PCB-Designern gehört, erfahren wir bei der Siegerehrung auf dem Festabend.



AUSSTELLUNG

Zeit und Raum zum Diskutieren und Netzwerken

Die FED-Konferenz ist die einzige deutschsprachige Veranstaltung, die den gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozess von elektronischen Baugruppen und Mikrosystemen in der Praxis der beteiligten Unternehmen umfasst. Seit 25 Jahren bringt die zweitägige Konferenz Fachleute aus der Industrie und angewandten Forschung zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zusammen. Die bewährte Plattform ermöglicht den Teilnehmern, aktuelle Entwicklungen kennenzulernen und einzuordnen und die Weichen rechtzeitig zu stellen.

Eine begleitende Ausstellung an beiden Konferenztagen bietet Raum und Zeit zum Informieren, Diskutieren und Netzwerken. Die Ausstellung befindet sich im Mittelpunkt des Veranstaltungsbereichs mit direktem Zugang zu den Vortragsräumen. Auf 760 Quadratmetern präsentieren sich Designdienstleister, Leiterplattenexperten, EMS-Firmen, Software-Anbieter und Zulieferer für die Elektronikfertigung.

Anmeldungen zur Ausstellung sind noch möglich. Bitte beachten Sie: Die Ausstellung ist sehr beliebt und die Anzahl der Ausstellungsplätze begrenzt. Melden Sie sich frühzeitig an!



Anmeldung und Teilnahmegebühren

Konferenzteilnahme (Preise in EUR, mehrwertsteuerfrei)

		FED-Mitglied	Nichtmitglied
01	Konferenz 1 Tag am Do, 27.09.2018 inkl. Abendveranstaltung	490	710
02	Konferenz 1 Tag am Fr, 28.09.2018	490	710
03	Konferenz 2 Tage, 27. und 28.09.2018 inkl. Abendveranstaltung	850	1.200
04	Begleitperson Festabend, 27.09.2018 ab 19:30 Uhr im Hegel-Saal, Bamberg	70	100

In den Teilnahmegebühren (01, 02, 03) sind enthalten: Konferenzteilnahme (Keynotes, Vorträge, Fachausstellung), Tagungsmappe, Mittagessen, Pausensnacks, Pausengetränke, 01 und 03 inkl. Abendveranstaltung am 27.09.2018

Firmenausstellung (Preise in EUR zzgl. MwSt.)

		FED-Mitglied	Nichtmitglied
A1	Aussteller Premium 2 Tage, 27. und 28.09.2018 freie Platzwahl lt. Ausstellerplan, Stand B 3,00 m x T 2,00 m, 2 Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (03), 1 Tisch, 2 Stühle, Werbepaket (P1, P3, P4)	3.690	5.490
A2	Aussteller Classic 2 Tage, 27. und 28.09.2018 Stand B 3,00 m x T 2,00 m, 1 Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (03), 1 Tisch, 2 Stühle	1.690	2.490
A3	zusätzlicher Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (03)	690	990

Werbe-/Sponsoringleistungen (Preise in EUR zzgl. MwSt.)

		FED-Mitglied	Nichtmitglied
P1	Logo Webseite 26. FED-Konferenz mit Link zur Unternehmenswebsite	480	650
P3	Logo Titelseite Konferenzprogrammheft (Größe ca. 30 x 20mm), ca. 64-seitig	370	490
P4	Anzeige Konferenzprogrammheft (Größe, ganzseitig ca. 180 x 260 mm), ca. 64-seitig	600	900

Werden Sie Sponsor für Tagungsmappen mit Ihrem Logo! Bitte sprechen Sie uns an (Mail an konferenz@fed.de).

Anmeldung und Teilnahmebedingungen
unter www.fedkonferenz.de

